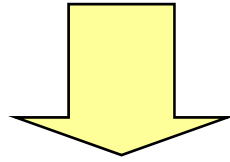
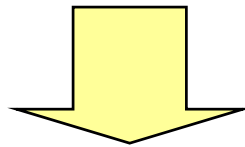


余白漆喰の断面構造や鉛の垂直分布等を明らかにすることで、壁画の劣化状態やそれを引き起こした原因等を明らかにするための基礎データが得られる。このデータは今後の修理にも役立つ重要な情報となる。



そのためには、断面方向にきちんと資料(試料)が残存している余白漆喰片のうち比較的大きな資料3~5点程度について、サンプリング調査を実施する必要がある。

(現在、計画している分析法は、発光分光分析法、偏光顕微鏡観察、電子顕微鏡観察等。)



奈良教育大学金原研究室蔵の余白漆喰片のうち最適な資料をサンプリング調査に供したい。



余白漆喰(奈良教育大学金原研究室蔵)ほぼ原寸大